

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **TQFP14-80PIN / Halogen free**

JEITA Package name; **P-TQFP080-1212-0.50**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.40 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	2.8	シリコン	7440-21-3	2.8	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.000006	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00001	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.00006	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00001	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.000006	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.00006	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.00006	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.00008	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.000006	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.06	ポリイミド	-	0.06	1000000	保護膜 ※4
	ダイアタッチ材	0.72	銀	7440-22-4	0.66	910000	主成分
			アクリル樹脂	-	0.05	70000	接着剤
			エポキシ樹脂	-	0.01	20000	接着剤
	端子メッキ	2.27	錫	7440-31-5	2.27	1000000	鉛フリーはんだ
	リードフレーム	158.28	銅	7440-50-8	149.57	945000	導体材
			銀	7440-22-4	0.79	5000	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	7.91	50000	添加剤
	ボンディングワイヤー	1.88	金	7440-57-5	1.88	1000000	導体材
	モールド樹脂	234.00	エポキシ樹脂	-	14.74	63000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	205.92	880000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.47	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	9.36	40000	硬化剤
			有機リン化合物	-	1.17	5000	硬化促進剤
			その他	-	2.34	10000	添加剤

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。
従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※5 ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が含まれます。